

- (1) เรียน อธิการบดี
- สอวช. ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายจากสมาคมแพรวจรแห่งประเทศไทย (THPCA) และสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ในงาน MHESI Job Fair วันที่ 10 พฤษภาคม 2568 กรุงเทพ
 - เห็นควรมอบ สวพ
 - เพื่อโปรดพิจารณา

นางสาวนันทกา เรืองศิริกุล
01 พฤษภาคม 2568

- (2) ๑.เห็นควรแจ้ง สวพ., ทุกคณะ
๒.โปรดทราบและพิจารณา

นางวรัญญานันท์ เมธีวัชรโยธิน
ผู้อำนวยการกองกลาง
01 พฤษภาคม 2568

- (3) -ควรดำเนินการตามเสนอ
-โปรดพิจารณา

นายจตุพร จันทรมา
ผู้อำนวยการ สำนักงานอธิการบดี
01 พฤษภาคม 2568

- (4) จัดตามเสนอ

รศ.วิไลลักษณ์ พรหมแสน
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการต่างประเทศ
02 พฤษภาคม 2568

สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ			
ค่วนที่สุด		บันทึกข้อความ	
ที่ อว 6201/ว1139		วันที่ 30 เมษายน 2568	
เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายจากสมาคมแพรวจรแห่งประเทศไทย (THPCA) และสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ในงาน MHESI Job Fair			
เรียน อธิการบดี ผู้อำนวยการสถาบัน (รายชื่อแจ้งท้าย)			
ด้วย กระทรวง อว. ได้จัดงาน MHESI Job Fair ระหว่างวันที่ 9 – 11 พฤษภาคม 2568 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อสร้างโอกาสในการมีงานทำให้กับบัณฑิตจบใหม่ และเสริมแกร่งการพัฒนาทักษะแรงงานให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดโลก โดยมุ่งหวังให้เป็นพื้นที่แห่งโอกาสที่ภาครัฐโดยกระทรวง อว. ใช้เชื่อมโยงระหว่างภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยมีสมาคมแพรวจรแห่งประเทศไทย (THPCA) เข้าร่วมบรรยายในหัวข้อ “ตำแหน่งงาน ทักษะ และจำนวนกำลังคนที่กำลังเป็นที่ต้องการสำหรับอุตสาหกรรมเคมีคอนดักเตอร์ และ PCB” และ สอวช. เข้าร่วมบรรยาย ในหัวข้อ “โมเดลความร่วมมือในการพัฒนากำลังคนเพื่อตอบโจทย์การจ้างงาน” ในวันที่เสาร์ที่ 10 พฤษภาคม 2568 เวลา 15.30 – 16.30 น. ณ เวทีกลาง งาน MHESI Job Fair ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์			
ในการนี้ สอวช. จึงขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมรับฟังการบรรยายดังกล่าว ตามวัน และเวลาข้างต้น โดยมีรายละเอียดการบรรยายฯ ปรากฏตามเอกสารแนบ			
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมรับฟังการบรรยายตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวด้วยจะขอขอบคุณยิ่ง			
 (นายสุรัชย์ สติคุณรัตน์) ผสอวช.			
เอกสารแนบ รายละเอียดการบรรยายฯ			
สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ โทรศัพท์ 02 109 5432 ต่อ 726 (พระราชพล) อีเมล phassapong@npo.or.th			



สอวช

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

รับเลขที่ ๒๐๓๓

วันที่ ๑ พ.ค. ๖๘

เวลา ๑๕.๕๓

ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ที่ อว 6201/ว1139

วันที่ 30 เมษายน 2568

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายจากสมาคมแพ่งวงจรแห่งประเทศไทย (THPCA) และสำนักงาน
นโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ในงาน MHESI Job Fair
เรียน อธิการบดี ผู้อำนวยการสถาบัน (รายชื่อแนบท้าย)

ด้วย กระทรวง อว. ได้จัดงาน MHESI Job Fair ระหว่างวันที่ 9 – 11 พฤษภาคม 2568 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อสร้างโอกาสในการมีงานทำให้กับบัณฑิตจบใหม่ และเสริมแกร่งการพัฒนาทักษะแรงงานให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดโลก โดยมุ่งหวังให้เป็นพื้นที่แห่งโอกาสที่ภาครัฐโดยกระทรวง อว. ใช้เชื่อมโยงระหว่างภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยมีสมาคมแพ่งวงจรแห่งประเทศไทย (THPCA) เข้าร่วมบรรยายในหัวข้อ “ตำแหน่งงาน ทักษะ และจำนวนกำลังคนที่กำลังเป็นที่ต้องการสำหรับอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ และ PCB” และ สอวช. เข้าร่วมบรรยาย ในหัวข้อ “โมเดลความร่วมมือในการพัฒนากำลังคนเพื่อตอบโจทย์การจ้างงาน” ในวันเสาร์ที่ 10 พฤษภาคม 2568 เวลา 15.30 – 16.30 น. ณ เวทีกลาง งาน MHESI Job Fair ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ในการนี้ สอวช. จึงขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมรับฟังการบรรยายดังกล่าว ตามวัน และเวลาข้างต้น โดยมีรายละเอียดการบรรยายฯ ปรากฏตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมรับฟังการบรรยายตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวด้วย
จะขอบคุณยิ่ง

(นายสุรัชย์ สติคุณรัตน์)

ผสอวช.

เอกสารแนบ รายละเอียดการบรรยายฯ

ปลดล็อกศักยภาพแรงงานไทย สู่อีโคโนมิกใหม่ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง

วันเสาร์ที่ 10 พฤษภาคม 2568 เวลา 15:30-16:30

เวทีกลาง งาน MHESI Job Fair ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

งาน MHESI Job Fair ที่จัดขึ้นโดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ระหว่างวันที่ 9-11 พฤษภาคม 2568 มีเป้าหมายหลักเพื่อสร้างโอกาสในการมีงานทำให้กับบัณฑิตจบใหม่ และเสริมแกร่งการพัฒนาทักษะแรงงานให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดโลก โดยมุ่งหวังให้เป็นพื้นที่แห่งโอกาสที่ภาครัฐโดย อว. ใช้เชื่อมโยงระหว่างภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

เวทีนำเสนอครั้งนี้จะมีการพูดถึงการลงทุนในอุตสาหกรรมที่ถือว่า “ร้อนแรงที่สุด” แห่งยุคดิจิทัล ได้แก่ เซมิคอนดักเตอร์ และ แผงวงจรพิมพ์ (PCB) ซึ่งเป็นหัวใจหลักของทุกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ในประเทศไทย ทั้งโอกาสในการเป็นศูนย์กลางการผลิตของภูมิภาค และแนวโน้มการจ้างงานและความต้องการด้านแรงงาน โดย คุณภูธนา ดาวเรือง จากสมาคมแผงวงจรแห่งประเทศไทย (THPCA) จะมานำเสนอตำแหน่งงาน ทักษะ และจำนวนกำลังคนที่กำลังเป็นที่ต้องการสำหรับอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ และ PCB

หนึ่งในไฮไลต์ของเวทีนี้คือการนำเสนอ “โมเดลความร่วมมือในการพัฒนากำลังคนเพื่อตอบโจทย์การจ้างงาน” สำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง ที่ สอวช. กำลังขับเคลื่อนร่วมกับพันธมิตรจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคการศึกษาและภาคเอกชน โดย ศ.ดร.สุรินทร์ คำฝอย รองผู้อำนวยการ สอวช. พร้อมทั้งแนะนำ STEMPlus Platform: เครื่องมือสนับสนุนการสร้างโอกาสสำหรับแรงงานยุคใหม่ ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างภาคอุตสาหกรรมกับอุดมศึกษา โดยมีฟังก์ชันหลากหลาย อาทิ

- การแจ้งความประสงค์ความต้องการกำลังคน
- การค้นหาหลักสูตรฝึกอบรมที่ผ่านการรับรองจาก สอวช. ตามมาตรการ Thailand Plus Package
- การขอรับรองการจ้างแรงงานลูกจ้างที่มีทักษะสูงด้าน STEM มาตรการ Thailand Plus Package
- การฝากประวัติสำหรับการสมัครงานหรือเข้าร่วมโครงการ
- การขอรับรองหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรด้าน STEM

และรวบรวมข้อมูลสนับสนุนด้านการพัฒนากำลังคน ได้แก่ การประกาศรับสมัครงาน ความต้องการทักษะบุคลากรสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย (Future Skills Set) ตัวอย่างโครงการพัฒนากำลังคน ความเชี่ยวชาญและการผลิตบุคลากรวิทยาศาสตร์ และสถิติด้านกำลังคน STEM

กิจกรรมที่เกิดขึ้นจะเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พัฒนากำลังคนของไทย ด้วยการเชื่อมโยงข้อมูล เทคโนโลยี และความร่วมมือในทุกภาคส่วน เพื่อสร้างแรงงานคุณภาพให้ตอบโจทย์เศรษฐกิจโลกยุคใหม่อย่างแท้จริง

? คำถามที่พบบ่อย (FAQs)

1. งานนี้เหมาะกับใคร?

เหมาะกับนิสิต นักศึกษา บัณฑิตจบใหม่ และผู้ที่สนใจงานในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี

2. มีการแจกเอกสารหรือข้อมูลเพิ่มเติมไหม?

มีแจกเอกสารดิจิทัลพร้อม QR Code ให้สแกนที่หน้างาน